

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

翱捷科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-0411

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	华泰证券、兴全基金、光大证券 人保资产、招商基金、华泰柏瑞 中欧基金、国金基金、域秀资产 泓澄投资
时间	2024年4月9、10、11日
上市公司接待人员姓名	董事长    戴保家 董事、董事会秘书、副总经理          韩旻 证券事务代表                                  白伟扬
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>Q：公司 2023 年业务收入构成如何？蜂窝芯片产品出货情况如何？</b></p> <p>A：2023 年，公司芯片产品、芯片定制业务和半导体 IP 授权三个主营业务板块分别实现收入 22.46 亿元、2.26 亿元和 1.23 亿元，占营业收入比例分别为 86.40%、8.70%和 4.75%。</p> <p>2023 年，公司蜂窝物联网主芯片出货数量较上年同期增长幅度超过 50%。蜂窝各产品系列持续迭代和丰富，市场规模扩大，据 TSR 2023 年度统计数据显示公司在 Cat.1bis 细分市场的份额排名第一。截至 2023 年末，公司 4G Cat.1 主芯片历年合计出货量超过 2.5 亿颗。</p>

	<p><b>Q: 听说个别竞争对手的 Cat. 1 价格很激进, 公司怎么看? 会有哪些措施来应对?</b></p> <p>A: 公司的主要应对措施有两点:</p> <p>第一是保持高研发效率和快速的产品迭代能力: 依托经验丰富的团队和深厚的 IP 积累, 结合市场需求, 持续进行产品迭代。</p> <p>第二是丰富现有的产品线, 打造更强的产品竞争力: 充分发挥同时具备蜂窝、非蜂窝等多种无线通信技术能力以及齐全的软硬件开发优势, 融合多种无线协议相关技术, 针对智能定位、可穿戴、共享经济、智能终端等多个细分市场, 推出差异化的解决方案。</p> <p><b>Q: 公司的毛利率水平是否已经稳住了? 还会有下降空间吗?</b></p> <p>A: 公司的综合毛利率水平还是主要由市场竞争程度而定, 目前评估 2024 年毛利率仍有压力, 不排除继续下探的可能。</p> <p><b>Q: 竞争对手的价格还会继续降吗?</b></p> <p>A: 竞争对手的价格策略基于各方面综合因素而定。若主要竞争对手继续降价, 公司将采取相应的价格策略进行应对。</p> <p><b>Q: 请问公司蜂窝芯片在车联网领域进展如何?</b></p> <p>A: 目前在车联网应用领域进展顺利, 载有公司芯片的模组已经在奇瑞、奔腾、长安、五菱等众多车型实现规模出货。</p> <p><b>Q: 请问公司蜂窝芯片在可穿戴领域后续计划如何?</b></p> <p>A: 在丰富原有儿童手表的产品线的基础上, 公司针对成人手表用户需求特点, 在“通信”、“续航”、“高集成度”</p>
--	--

三大核心能力上持续提升，推出专门产品线，提供一站式解决方案和高效的技术支持，助力客户加快产品落地。

**Q：公司感觉今年下游有什么新机会吗？**

A：某些市场可能会有增量，例如智能可穿戴、车联网、MBB、工业控制类等。

**Q：5G RedCap 方面的进展如何？看报道，公司在 MWC 展会上也有相关展示。**

A：公司的 5G RedCap 芯片在 MWC 展会上受到了广泛关注，许多海外客户也到展位了解相关产品。目前，RedCap 芯片的进展顺利。

**Q：公司智能手机芯片业务的进展？**

A：公司智能手机芯片已经开始供货给客户，后续具体出货量要视客户手机的市场推广进度而定。

**Q：公司八核智能手机芯片后续计划？**

A：八核手机芯片已经研发立项，预计今年第四季度工程流片，正式推出市场的时间还需视具体研发、测试及市场情况而定。

**Q：如果按照 2024 年四核开始出货的进展来看，2025 年是不是很难看到八核产品的出货？**

A：不一定。因为首颗芯片开发周期会比较长，后续芯片是迭代产品，相比第一代产品从 0 到 1 会快很多。

**Q：我们注意到，公司的人均薪酬高于 A 股其他芯片上市公司，请问公司怎么看？**

A：公司是目前 A 股唯一的基带芯片公司，人均薪酬较高符合所从事领域的特点。基带芯片研发设计工作难度大，技

	<p>术和投资门槛高，对员工专业知识储备及行业经验要求高。截止 2023 年末，公司员工硕博占比超过 2/3，且多数具有十几年以上的工作经验，在人才市场上极具竞争力。在现有团队运作下，公司已经成功推出芯片超过 60 颗，涵盖 2G-5G 全制式蜂窝基带芯片和非物联网芯片两大门类，并开始进军智能手机芯片市场。</p> <p><b>Q：随着公司人数增加，公司企业文化是否会有变化？</b></p> <p>A：公司底层的文化如包容开放、鼓励创新、追求卓越等不会改变，具体管理机制会随着人员规模扩大而进行适当调整。</p> <p><b>Q：台积电是否有给公司降价？</b></p> <p>A：晶圆厂会根据客户订单数量、市场环境以及自身产能情况等对价格进行调整，因为公司与晶圆厂有签订保密协议，这方面内容不方便透露。</p>
附件清单（如有）	无